

3 证券代码：688521

证券简称：芯原股份

芯原微电子（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（ ）
参与单位名称	<u>2025年3月4日</u> 富国基金、上海云钜创业投资、元禾控股等 <u>2025年3月5日</u> 凯联资本、信达资本、中和资本、泓德基金等 <u>2025年3月6日</u> 中移资本、大家资管、建信基金、工银瑞信等
时间	2025年3月4日、2025年3月5日、2025年3月6日
调研方式	线下会议
公司接待人员姓名	公司董事长兼总裁：WAYNE WEI-MING DAI（戴伟民）
投资者关系活动主要内容介绍	
公司介绍	芯原是一家依托自主半导体IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的企业。

公司拥有自主可控的图形处理器 IP（GPU IP）、神经网络处理器 IP（NPU IP）、视频处理器 IP（VPU IP）、数字信号处理器 IP（DSP IP）、图像信号处理器 IP（ISP IP）和显示处理器 IP（Display Processor IP）这六类处理器 IP，以及 1,600 多个数模混合 IP 和射频 IP。

基于自有的 IP，公司已拥有丰富的面向人工智能（AI）应用的软硬件芯片定制平台解决方案，涵盖如智能手表、AR/VR 眼镜等实时在线（Always on）的轻量化空间计算设备，AI PC、AI 手机、智慧汽车、机器人等高效率端侧计算设备，以及数据中心/服务器等高性能云侧计算设备。

为顺应大算力需求所推动的 SoC（系统级芯片）向 SiP（系统级封装）发展的趋势，芯原正在以“IP 芯片化（IP as a Chiplet）”、“芯片平台化（Chiplet as a Platform）”和“平台生态化（Platform as an Ecosystem）”理念为行动指导方针，从接口 IP、Chiplet 芯片架构、先进封装技术、面向 AIGC 和智慧出行的解决方案等方面入手，持续推进公司 Chiplet 技术、项目的研究和产业化。

基于公司独有的芯片设计平台即服务（Silicon Platform as a Service, SiPaaS）经营模式，目前公司主营业务的应用领域广泛包括消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等，主要客户包括芯片设计公司、IDM、系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商等。

芯原在传统 CMOS、先进 FinFET 和 FD-SOI 等全球主流半导体工艺节点上都具有优秀的设计能力。在先进半导体工艺节点方面，公司已拥有 14nm/10nm/7nm/6nm/5nmFinFET 和 28nm/22nmFD-SOI 工艺节点芯片的成功流片经验。此外，根据 IPnest 在 2024 年 5 月的统计，2023 年，芯原半导体 IP 授权业务市场占有率为列中国第一，全球第八；2023 年，芯原的知识产权授权使用费收入排名全球第六。根据 IPnest 的 IP 分类和各企业公开信息，芯原 IP 种类在全球排名前十的 IP 企业中排名前二。

2020 年至 2022 年，公司营业收入复合增长率约为 33%。2021 年，

在行业产能紧张的情况下，公司实现量产业务收入同比增长约 35%，营业收入同比增长约 42%，实现净利润扭亏为盈。2022 年，全球半导体产业下行，公司营业收入逆势增长约 25%，净利润与扣非后净利润均实现盈利，成功实现了“摘 U”。2023 年，在产业环境非常艰难的情况下，公司仍然保持了上半年净利润、扣非后净利润均为正。受全球经济增速放缓，半导体行业周期下行以及去库存的影响，公司仅三个季度收入同比下滑。2024 年上半年，半导体产业逐步复苏，得益于公司独特的商业模式，即原则上无产品库存的风险，无应用领域的边界，公司自二季度起，经营情况快速扭转。公司 2024 年第二季度营业收入规模同比恢复到受行业周期影响前水平，2024 年第三季度营业收入创历年三季度收入新高，同比增长 23.60%，根据公司《2024 年年度业绩快报公告》，公司预计第四季度收入同比增长超 17%，全年营业收入预计基本与 2023 年持平。2024 年下半年，公司芯片设计业务收入同比增长约 81%，知识产权授权使用费业务收入同比增长约 21%，量产业务收入同比下降约 4%。2024 年第四季度，公司芯片设计业务收入同比增长约 81%，知识产权授权使用费业务收入同比下降约 28%，量产业务收入同比增长约 32%，体现了公司收入受行业下行周期影响较晚、恢复增长较早的特点。

截至 2024 年末，公司订单情况良好，在手订单 24.06 亿元，较三季度末的 21.38 亿元进一步提升近 13%，在手订单已连续五季度保持高位。从新签订单角度，2024 年四季度公司新签订单超 9.4 亿元，2024 年下半年新签订单总额较 2024 年上半年提升超 38%，较 2023 年下半年同比提升超 36%，较半导体行业周期下行及去库存影响下的 2023 年上半年大幅提升超 66%，对公司未来的业务拓展及业绩转化奠定坚实基础。

经过 20 多年的持续高研发投入，公司已经拥有丰富且优质的技术储备，并在别的公司不招人、少招人的产业下行周期，芯原逆向思维，在 2024 届校招中近 1 万人进行了全球统一在线笔试，约 1,800 人进入面试环节，我们录取了 200 多名应届毕业生，其中，硕士 985、211 的占比为

	<p>97%，其中本硕都是 985、211 的占比 85%。</p> <p>公司潜心投入关键应用领域技术研发，如五年前开始布局 Chiplet 技术及其在生成式人工智能和智慧驾驶上的应用。公司在三年前就开始研发超轻量、超低功耗的 AI/AR 眼镜芯片设计平台，为全球知名的互联网企业定制了 AR 眼镜专用芯片，还与其始终在线的开源项目展开深度合作，形成了完整的技术平台。以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2024 年年度报告为准。</p>
交流问答	<p>问题：请问公司系统厂商、互联网公司和云服务提供商等客户群体在整个收入结构中占比多少？公司如何看待未来客户群体的变化趋势？</p> <p>回复：公司来自系统厂商、大型互联网公司和云服务提供商等非芯片公司客户群体的收入约占整体收入四成。近年来，系统厂商、互联网公司和云服务提供商因成本、差异化竞争等原因，越来越多地开始设计自有品牌的芯片，而这类企业因为芯片设计能力、资源和经验相对欠缺，大多会寻求与半导体 IP 公司或芯片设计服务公司进行合作。芯原拥有先进的芯片定制技术、丰富的 IP 储备，延伸至软件和系统平台的设计能力，已成为这几类客户首选的芯片设计服务合作伙伴之一。</p> <p>这几类客户带来的收入成长，一方面体现在，由于更多的公司进入到芯片设计这个领域，产生了更多半导体 IP 的需求，带动公司 IP 授权业务的成长；另外，我们芯片定制服务的一些系统厂商、互联网企业和云服务提供商客户，项目已进入量产阶段，客户的业务增长会直接带动公司量产业务收入的增长。</p> <p>问题：请问如何看待特许权使用费收入的增长性？</p> <p>回复：在公司半导体 IP 授权业务中，公司在向客户交付半导体 IP 时，会收取知识产权授权使用费收入，待客户利用该 IP 完成芯片设计并</p>

量产后，公司会根据客户的芯片销售情况，按照量产芯片销售颗数获取特许权使用费收入。长期来看，随着公司半导体 IP 广泛授权，以及客户出货量增长，公司特许权使用费业务收入将呈现增长趋势。

问题：请问公司如何展望未来境内外收入占比？

回复：公司始终重视扩充海内外客户资源，关注全球市场机遇，实现境内外业务同步发展，长期来看，公司境外收入占比约占整体收入的三成左右。在 2024 年前三季度，公司境内销售收入占营业收入比重约 65%，境外销售收入占比约 35%。

问题：请问公司在自动驾驶领域的技术布局与客户合作情况如何？

回复：近年来，公司聚焦快速增长的汽车电子领域，芯片设计流程已获得 ISO 26262 汽车功能安全管理体系建设认证，通过这个认证将加速公司在电动汽车和智能汽车领域的战略布局；此外，芯原还推出了功能安全（FuSa）SoC 平台的总体设计流程，以及基于该平台的高级驾驶辅助系统（ADAS）功能安全方案，并搭建了完整的自动驾驶软件平台框架。

基于上述技术布局，芯原已经积累了为汽车厂商设计高性能车规 ADAS 芯片的相关经验，例如为某知名新能源汽车厂商提供基于 5nm 车规工艺制程的自动驾驶芯片定制服务，其中集成了芯原的多个半导体 IP，并符合 ISO 26262 功能安全标准，性能全球领先。目前芯原正在与一系列汽车领域的关键客户进行深入合作，以在智慧出行领域取得更好的发展机会。

问题：请问公司目前研发人员数量是多少，在人才储备上有什么计划？

回复：公司高度重视人才培养，坚持引进和培养优秀人才是公司生

存和发展的关键，也是公司持续提高核心竞争力的基础，截至 2024 年末，公司研发人员 1800 人，占整体人员比重约九成。公司基于战略考虑坚持引进和储备优秀人才，集成电路设计行业为典型的人才密集型行业，且人员具有一定的培养周期，公司也将在持续优化迭代现有核心技术的基础上，进一步就 AIGC、汽车、数据中心、智慧可穿戴、智慧物联网这几个关键应用领域进行人才培养、储备和激励，在别的公司不招人、少招人的情况下，芯原逆向思维，在 2024 届校招中近 1 万人进行了全球统一在线笔试，约 1,800 人进入面试环节，我们录取了 200 多名应届毕业生，其中，硕士 985、211 的占比为 97%，其中本硕都是 985、211 的占比 85%。